

Elektroprzewodzący dodatek

PCI Elektroleit

do cementowych zapraw
klejących i spoinowych PCI



Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych w połączeniu z zaprawami klejącymi i do spoinowania firmy PCI.
- Do posadzek.
- Jako dodatek do zaprawy PCI Flexmörtel[®] S1 flott i PCI Flexfug[®] przy wykonywaniu płytkowych okładzin elektroprzewodzących.
- Do sal operacyjnych w szpitalach, do przesypowni materiałów pyłących (zagrożenie eksplozją pyłu), do magazynów i rozlewni produktów rozpuszczalnikowych, do serwerowni komputerowych oraz laboratoriów fizyko-chemicznych.
- Do wykonywania zapraw do spoinowania w kolorze antracytowym.

Właściwości produktu

- **Elektroprzewodzący**, umożliwia odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, gromadzących się na okładzinie ceramicznej.
- **Nie zawiera rozpuszczalników**, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia wykonawcy robót, ani zagrożenia dla środowiska, brak ryzyka pożaru czy też eksplozji oparów.
- **Łatwy w użyciu**, wystarczy dodać do wody zarobowej do zaprawy klejowej lub zaprawy do spoinowania.

Dane techniczne

Baza materiałowa	elektroprzewodząca dyspersja zawierająca pigment węglowy
Składniki	produkt 1 -składnikowy
Kolor	czarny
Konsystencja	płynna
Trwałość składowania	12 miesięcy
Składowanie	w suchym miejscu, chronić przed mrozem, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	kanister 4 kg

Zaprawy z dodatkiem PCI Elektroleit	PCI Flexmörtel® S1 flott + PCI Elektroleit	PCI Flexfug® piaskowoszara + PCI Elektroleit
Proporcja składników:		
- zaprawa cementowa	20 kg	25 kg
- PCI Elektroleit	1,6 kg	2 kg
- woda	4,4 l	4,0 l
Grubość warstwy kleju / szerokość spoiny	1 do 10 mm	3 do 15 mm
Temperatura aplikacji i podłoża	+5 do +25 °C	+5 do +25 °C
Czas użycia*	ok. 3 godziny	ok. 35 minut
Czas dojrzewania	ok. 3 minut	ok. 3 minut
Czas otwarty klejenia*	ok. 20 minut	---
Czasy utwardzania:*		
- Możliwość wchodzenia po	ok. 12 godzinach	ok. 2 godzinach
- Pełne obciążenie po	ok. 7 dniach	ok. 7 dniach
Odporność termiczna	-20 do +80 °C	-20 do +80 °C
Oporność elektryczna zaprawy w Ω wg PN-EN 1081 (w połączeniu z płytką elektroprzewodzącą)	ok. 10 ⁵	ok. 10 ⁵

* Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
 - jastrych PCI Novoment® M1 plus: ok. 24 godziny;
 - jastrych PCI Novoment® Z3: ok. 3 dni;
 - tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;
 - beton: ok. 3 miesiące.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Silnie chłonne podłoża cementowe (maks. wilgotność szczątkowa 4% CM) należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1:1 z wodą.
- Podłoża gipsowe (maks. wilgotność szczątkowa 0,5% CM) zagruntować nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.

Sposób użycia

Układanie taśmy PCI Kupferband

Należy wykonać zgodnie z Kartą Techniczną PCI Kupferband.

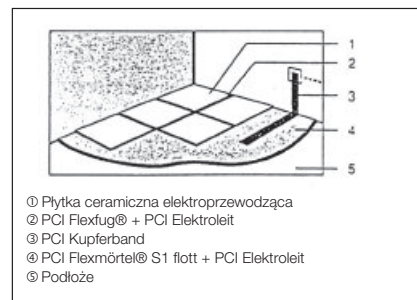
Przygotowanie zaprawy klejącej

Do czystego naczynia zarobowego nalać odpowiednią ilość wody. Dodać potrzebną ilość PCI Elektroleit i dokładnie wymieszać. Dodać proszek

PCI Flexmörtel® S1 flott i wymieszać odpowiednim mieszadłem w celu uzyskania plastycznej, jednorodnej zaprawy. Po odczekaniu czasu dojrzewania ponownie krótko przemieszać.

Przyklejanie płytek

Postępować zgodnie z instrukcją użycia, opisaną w Karcie Technicznej



Sposób użycia

PCI Flexmörtel® S1 flott, jednak dodatkowo gładką stroną packi przesmarować spód płytek - analogicznie jak w „kombinowanej” metodzie przyklejania płytek.

Zalecenia i uwagi

- W przypadku okładzin poddawanych obciążeniom chemicznym i/lub myciu myjkami ciśnieniowymi należy do fugowania użyć epoksydową zaprawę PCI Durapox® EL.
- Dodatek PCI Elektroleit może spowolnić tempo twardnienia zaprawy klejącej i do spoinowania.
- Do wykonania zaprawy spoinowej na bazie PCI Flexfug® należy używać tylko koloru piaskowoszarego.
- Po dodaniu PCI Elektroleit zaprawa do spoinowania uzyskuje kolor antracytowy.
- Przyłączenie taśmy PCI Kupferband do instalacji uziemiającej winno być wykonane przez uprawnionego elektryka.

Przygotowanie zaprawy do spoinowania

Do czystego naczynia zarobowego nalać odpowiednią ilość wody. Dolać potrzebną ilość PCI Elektroleit i dokładnie wymieszać. Dodać proszek PCI Flexfug® w kolorze piaskowoszarym i wymieszać odpowiednim

- W przypadku płytek o szorstkiej powierzchni (np. antypoślizgowych) należy jeszcze w stanie świeżym dokładnie zmyć z nich pozostałości zaprawy do spoinowania.
- Zmywanie płytek po spoinowaniu wymaga częstszego zmieniania wody - podobnie jak w przypadku typowych fug w kolorze czarnym.
- Naczynia i narzędzia należy jeszcze w stanie świeżym umyć wodą, gdyż po stwardnieniu resztek zapraw konieczne będzie ich usuwanie mechanicznie.
- Odnośnie do spoinowania należy przestrzegać wytycznych producenta płytek. W określonych przez niego przypadkach spoinowanie zaprawą

mieszadłem dla uzyskania plastycznej, jednorodnej zaprawy. Po odczekaniu czasu dojrzewania ponownie krótko przemieszać.

Spoinowanie płytek

Postępować zgodnie z instrukcją użycia, opisaną w Karcie Technicznej PCI Flexfug®.

elektroprzewodzącą może okazać się niekoniecznym, w żadnym razie nie można jednak zrezygnować z zastosowania elektroprzewodzącej zaprawy klejącej.

- **Podane w Danych technicznych wartości oporności elektrycznej odnoszą się do samych produktów PCI, nie zaś do wykonanej przy ich użyciu okładziny. Na oporność okładziny wpływa przede wszystkim przewodność płytek!**
- **Należy stosować płytki, które w całym swoim przekroju wykonane są z materiału o odpowiedniej oporności lub posiadają na wierzchu i na powierzchniach czołowych, stykających się z klejem do płytek, wystarczająco przewodzącą glazurę.**

Wskazówki BHP

PCI Elektroleit zawiera biocyd (środek konserwujący produkt w opakowaniu): mieszanekę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazolu-3-on i 2-metylo-2H-izotiazolu-3-on (proporcja 1:3). Może wywołać reakcje alergiczne. Nie dopuszczać dzieci do kontaktu

z produktem. W trakcie użycia nosić rękawice ochronne i chronić oczy przed zapryskaniem. W razie dostania się do oczu, płukać obficie wodą. Gdy podrażnienie nie ustąpi po kilku minutach, udać się do okulisty i przedłożyć

opakowanie lub etykietę produktu. Przestrzegać zasad obchodzenia się z produktami cementowymi, zawartych w kartach technicznych PCI Flexfug® i PCI Flexmörtel® S1 flott.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta techniczna

PCI Elektroleit

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myślenice

Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34

www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Karta techniczna nr 602 wydanie: Marzec 2021.

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność.

Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl